



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2019 年第三季自結財務報告

2019 年 10 月 25 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(25)日公告 2019 年第三季自結財務報告。

2019 年第三季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 64.04 億元，為歷史新高，較前季增加 44%，較去年同期增加 58%
- ◆ 本季合併毛利率為 42.1%，為歷史新高，較前季增加 8.1 個百分點；
本季營業淨利率 31.4%，為歷史次高，較前季增加 10.8 個百分點
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 20.12 億元，較前季增加 119%，較去年同期增加 369%
- ◆ 本季稅後淨利為新台幣 16.37 億元，為歷史新高，較前季增加 112%，較去年同期增加 135%；每股盈餘為新台幣 3.90 元，為歷史新高，前季為新台幣 1.87 元

2019 年第四季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 第四季營收預計較第三季成長 mid-single digit。
- ◆ 第四季毛利率預計約與第三季相當。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

管理者評論

“首先，我們很高興看到2019年第三季穩懋營運再度締造了數個歷史高峰。第三季營收為新台幣64億元，季成長率及年成長率分別為+44%及+58%，這是繼2017年第四季之後穩懋營收再次達到另一個歷史高點，累計前三季營收為新台幣144.7億元，年成長率為+11%。穩懋甫於第二季底開出新產能，第三季在強勁的客戶需求之下，即時搭上了旺季的列車，在產能利用率攀高的同時，毛利率上升到42.1%的歷史新高，營業利益率31.4%達到歷史次高水位，淨利及EPS也分別創下了新台幣16.4億元及3.9元的單季歷史新高。

在第三季手機傳統旺季需求帶動下，穩懋整體營收從七月開始就明顯反應旺季的需求，連續三個月都創單月新高紀錄。相對於前一季，第三季舉凡應用於手機中的Cellular、Wi-Fi及VCSEL晶片出貨都有顯著成長，就連季節性不甚明顯的基礎建設相關需求也都延續上半年的成長動能，有不錯的表現，使得目前穩懋產能再度面臨吃緊狀態。為因應明年5G的終端需求，穩懋近期宣布啟動新一輪的擴充計畫，月產能將從目前的3.6萬片擴大到4.1萬片，可望於明年第二季開始貢獻產能，為旺季需求預做準備。

2019年可以稱為5G元年，雖然目前5G網絡還不普及，但各國的電信商及手機製造商無不摩拳擦掌，期望取得先機。我們樂見目前穩懋手機PA出貨中5G佔比已超過一成，並堅信未來幾年隨著5G通信的逐年普及，將成為穩懋中長期穩定的成長動能。

展望2019年第四季，在客戶需求依然強勁之下，我們預計季營收成長率為mid-single digit，毛利率約與第三季相當。同時，2019年穩懋全年營收預估較去年成長超過兩成的水準，可望優於台灣半導體產業成長0.1%及全球半導體產業衰退13.3%的預期。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於1999年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司(RFIC Design Houses)外，並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及3D感測領域中，穩懋更以MMIC生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。